

2017-2022年中国芯片产业运营现状及投资战略分析报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国芯片产业运营现状及投资战略分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/289387289387.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

1目前移动芯片产业的发展状况

LTE正处于全球快速发展的大局势之下，而移动终端的核心产业则是移动芯片，移动芯片产业随之迎来了最佳的发展机遇。由于我国的通用移动通信技术发展较晚，在3G时代的移动芯片企业无论是从制造工艺，还是技术水平方面都存在一定的缺陷。但随着4G时代的到来，我国更加关注移动芯片产业的核心技术，制定相应的政策大力扶持移动芯片企业，有效提高了我国移动芯片企业的市场竞争力。然而随着通用移动通信技术的日益发展，人们对于我国移动芯片企业提出更高的技术要求，为此，有必要充分了解当前移动芯片产业的发展状况，并探讨出这一产业发展的促进措施。

1.1LTE对于移动芯片的发展起决定性作用

LTE具有两个明显的特征:产业化、商业化。LTE产业逐渐走向成熟，而这种现象的产生主要是各国电信管理部门、运营商以及通信设备制造商三方面造成的，据不完全统计，2015年全球使用LTE网络的用户接近4亿，随着近年来经济全球化趋势的不断加强，移动通信设备也在逐年递增，因而使用LTE网络的人群也在增加。

处在信息化时代加速发展的形式之下，我国已从最初2G时代移动芯片产业的薄弱期逐渐蜕变为具有高超技术水平的成熟期，并且在通用移动通信技术方面加大了投入，对4G网络的建设做出了卓越的贡献，中国移动、中国电信以及中国联通三大通信运营商对于4G网络的普及发挥着巨大的作用。LTE的快速发展，极大促进了移动通信设备的普及，从而带动移动芯片产业的发展。

1.2移动芯片市场处于垄断地位

随着近年来移动通信设备的大量普及，全球移动芯片的出货量正在逐年增长，预计超过30亿颗，收益额将超过300亿美元。不过随着移动芯片的制作工艺与技术水平的不断提高，促使移动芯片产业的门槛也在提高，全球移动芯片的市场份额大都集中在少数移动芯片公司手中。其中以高通、联发科两家移动芯片企业为主，且占据着全球移动芯片市场的六成，致使其他移动芯片企业处在困境之中。由于全球移动芯片市场处于一种垄断的地位，很多规模较小(博通等)的移动芯片企业选择转行，退出移动芯片行业。

1.3我国移动芯片企业的国内市场占有率在逐步提高

通过对全球移动芯片出货量进行统计得出，我国的移动芯片企业在国内市场仍然取得不错的成绩。国内的移动芯片企业通过对前期2G、3G网络的建设与研发，技术方面较为成熟，随着4G时代的建设，国内以其精湛的技术赢得了移动芯片市场的一席之地。根据国内相关机构的报道，以展讯移动芯片企业为例，2015年其移动芯片在全球范围内的出货量高达4亿颗，特别是在国内移动市场表现突出。不仅如此，我国制定相关的政策与条文大力扶持国内移动芯片企业的发展，为国内企业的技术发展提供了扎实的基础。

2我国移动芯片产业未来发展道路

LTE处于商业化时期，LTE-A技术发展最主要的目的是提升移动芯片本身的性能。由于LTE采用各种不同的制式以及频段，因此，移动芯片的制定具有多元化的特点，需要根据不同的需求研发出与其相符的移动芯片类型。

2.1移动芯片研发的方向集中于多模多频

移动通信制式是多元化的，包括2G、3G以及LTE等制式，并不会因移动通信技术的迅猛发展而采取单一的制式，多模多频的移动通信制式依然会并存。移动芯片大多是根据移动通信技术的要求而进行研发的，当前大多数移动芯片企业对于移动芯片的研发集中于5模多频方向。移动芯片多模多频方向的研究势必是其未来发展的重心，同时其也是移动芯片市场的主打产品。

2.2一体化移动芯片势必是其发展的新格局

移动通信制式对移动芯片产生巨大的影响，随着移动通信制式频段数量的进一步提高，移动芯片在性能、容量等方面对移动芯片企业而言面临着不小的挑战，通过将移动芯片基带和射频等集芯片于一体，因而移动芯片企业必须提升制作工艺，从而减少移动芯片在功耗、性能方面的缺陷。

2.3合并和相互合作是移动芯片企业发展的重要形式

移动通信技术发展之初，移动芯片技术水平要求不高，因而大部分企业都采取最为简单的模式制作移动芯片，然而随着信息时代移动通信技术的迅猛发展，移动芯片设计企业也随之快速兴起，从而致使移动芯片产业的竞争力不断加大。以往的移动芯片企业已经跟不上移动通信技术的步伐，因而要想取得长足的发展，移动芯片企业可以通过合并或者相互合作

的形式实现双方移动芯片技术优势的互补，以高品质的质量提高市场竞争力。

中国报告网发布的《2017-2022年中国芯片产业运营现状及投资战略分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章：中国芯片行业发展综述

1.1 芯片行业概述

1.1.1 芯片的定义分析

1.1.2 芯片制作过程介绍

- (1) 原料晶圆
- (2) 晶圆涂膜
- (3) 光刻显影
- (4) 掺杂杂质
- (5) 晶圆测试
- (6) 芯片封装
- (7) 测试包装

1.1.3 芯片产业链介绍

- (1) 产业链上游市场分析
- (2) 产业链下游市场分析

1.2 芯片行业发展环境分析

1.2.1 行业政策环境分析

- (1) 行业标准与法规
- (2) 行业发展政策
- (3) 行业发展规划

1.2.2 行业经济环境分析

- (1) 国民经济运行状况
- (2) 工业经济增长情况
- (3) 固定资产投资情况
- (4) 经济转型升级形势
- (5) 宏观经济发展趋势

1.2.3 行业社会环境分析

- (1) 互联网加速发展
- (2) 智能产品的普及
- (3) 科技人才队伍壮大

1.2.4 行业技术环境分析

- (1) 技术研发进展
- (2) 无线芯片技术
- (3) 技术发展趋势

1.3 芯片行业发展机遇与威胁分析

第二章：全球芯片行业发展状况分析

2.1 全球芯片行业发展状况综述

- 2.1.1 全球芯片行业发展历程
- 2.1.2 全球芯片市场特点分析
- 2.1.3 全球芯片行业市场规模
- 2.1.4 全球芯片行业竞争格局
- 2.1.5 全球芯片行业区域分布
- 2.1.6 全球芯片行业需求领域
- 2.1.7 全球芯片行业前景预测

2.2 美国芯片行业发展状况分析

- 2.2.1 美国芯片市场规模分析
- 2.2.2 美国芯片竞争格局分析
 - (1) IC设计企业
 - (2) 半导体设备厂商
 - (3) EDA巨头
 - (4) 第三代半导体材料企业
 - (5) 模拟器件

2.2.3 美国芯片市场结构分析

2.2.4 美国芯片技术研发进展

2.2.5 美国芯片市场前景预测

2.3 日本芯片行业发展分析

2.3.1 日本芯片行业发展历程

- (1) 崛起：1970s，VLSI研发联合体带动技术创新
- (2) 鼎盛：1980s，依靠低价战略迅速占领市场
- (3) 衰落：1990s，技术和成本优势丧失，市场份额迅速跌落
- (4) 转型：2000s，合并整合与转型SOC

2.3.2 日本芯片市场规模分析

2.3.3 日本芯片竞争格局分析

- (1) 日本材料半导体
- (2) 日本半导体设备

2.3.4 日本芯片技术研发进展

2.3.5 日本芯片市场前景预测

2.4 韩国芯片行业发展分析

2.4.1 韩国芯片行业发展历程

- (1) 发展路径
 - (2) 发展动力
- 1) 政府推动
 - 2) 产学研合作

- 3) 企业从引进到自主研发

2.4.2 韩国芯片市场规模分析

2.4.3 韩国芯片竞争格局分析

2.4.4 韩国芯片技术研发进展

2.4.5 韩国芯片市场前景预测

2.5 台湾芯片行业发展分析

2.5.1 台湾芯片行业发展历程

- (1) 萌芽期（1964-1974年）
- (2) 技术引进期（1974-1979年）
- (3) 技术自立及扩散期（1979年至今）

2.5.2 台湾芯片市场规模分析

2.5.3 台湾芯片竞争格局分析

2.5.4 台湾芯片技术研发进展

2.5.5 台湾芯片市场前景预测

2.6 其他国家芯片行业发展分析

2.6.1 印度芯片行业发展分析

2.6.2 英国芯片行业发展分析

2.6.3 德国芯片行业发展分析

(1) 德国芯片行业发展现状

(2) 德国芯片技术研发进展

2.6.4 瑞士芯片行业发展分析

第三章：中国芯片行业发展状况分析

3.1 中国芯片行业发展综述

3.1.1 中国芯片产业发展历程

3.1.2 中国芯片行业发展地位

3.1.3 中国芯片行业市场规模

3.2 中国芯片市场格局分析

3.2.1 中国芯片市场竞争格局

3.2.2 中国芯片行业利润流向

3.2.3 中国芯片市场发展动态

3.3 中国量子芯片发展进程

3.3.1 产品发展历程

3.3.2 市场发展形势

3.3.3 产品研发动态

3.3.4 未来发展前景

3.4 中国芯片产业区域发展动态

3.4.1 湖南

(1) 总体发展动态

(2) 细分优势明显

(3) 未来发展前景

3.4.2 贵州

3.4.3 北京

(1) 总体发展动态分析

(2) 北设计——中关村

(3) 南制造——亦庄

3.4.4 晋江

(1) 晋华项目落地

(2) 安芯基金启动

(3) 发展芯片行业的优势

1) 交通便利区位优势明显

2) 政策扶持惠企引才并重

- 3) 科创体系形成产业支撑
- 4) 配套完善建设宜居城市
- 3.5 中国芯片产业发展问题分析
 - 3.5.1 产业发展困境
 - 3.5.2 开发速度放缓
 - 3.5.3 市场垄断困境
 - (1) 芯片垄断现状
 - (2) 芯片垄断形成原因
- 3.6 中国芯片产业应对策略分析
 - 3.6.1 企业发展战略
 - 3.6.2 突破垄断策略
 - 3.6.3 加强技术研发

第四章：芯片行业细分产品市场分析

- 4.1 芯片行业产品结构概况
 - 4.1.1 芯片产品类型介绍
 - 4.1.2 芯片产品结构分析
- 4.2 LED芯片市场分析
 - 4.2.1 LED芯片发展现状
 - (1) LED芯片材料选择
 - (2) LED芯片涨价由RGB向白光蔓延，结构型供需失衡显现
 - (3) 价格战挤出效应明显，行业竞争格局改善
 - (4) 台厂聚焦四元芯片市场，GaNLED产业中心向大陆转移加速
 - 4.2.2 LED芯片市场规模
 - 4.2.3 LED芯片竞争格局
 - (1) 国际竞争格局
 - (2) 国内竞争格局
 - 4.2.4 LED芯片前景预测
- 4.3 SIM芯片市场分析
 - 4.3.1 SIM芯片发展现状
 - 4.3.2 SIM芯片市场规模
 - (1) SIM芯片整体出货量
 - (2) NFC类SIM卡出货量
 - (3) LTE类SIM卡出货量
 - 4.3.3 SIM芯片竞争格局

4.3.4 SIM芯片前景预测

4.4 移动支付芯片市场分析

4.4.1 移动支付芯片发展现状

- (1) 移动支付产品分析
- (2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决
- (3) 已有大量POS机支持NFC功能
- (4) 国内供应商开始发力NFC芯片

4.4.2 移动支付芯片市场规模

4.4.3 移动支付芯片竞争格局

4.4.4 移动支付芯片前景预测

4.5 身份识别类芯片市场分析

4.5.1 身份识别类芯片发展现状

- (1) 身份识别介绍
- (2) 身份识别分类

4.5.2 身份识别类芯片市场规模

4.5.3 身份识别类芯片竞争格局

- (1) 国内厂商产能扩大
- (2) 缺乏自主知识产权
- (3) 安全性尚待加强
- (4) 应用尚待开发
- (5) 解决方案仍在探索
- (6) 上游产能不足

4.5.4 身份识别类芯片前景预测

4.6 金融支付类芯片市场分析

4.6.1 金融支付类芯片发展现状

4.6.2 金融支付类芯片市场规模

4.6.3 金融支付类芯片竞争格局

4.6.4 金融支付类芯片前景预测

4.7 USB-KEY芯片市场分析

4.7.1 USB-KEY芯片发展现状

4.7.2 USB-KEY芯片市场规模

4.7.3 USB-KEY芯片竞争格局

4.7.4 USB-KEY芯片前景预测

4.8 通讯射频芯片市场分析

4.8.1 通讯射频芯片发展现状

4.8.2 通讯射频芯片市场规模

4.8.3 通讯射频芯片竞争格局

4.8.4 通讯射频芯片前景预测

4.9 通讯基带芯片市场分析

4.9.1 通讯基带芯片发展现状

4.9.2 通讯基带芯片市场规模

4.9.3 通讯基带芯片竞争格局

(1) 国际厂商竞争格局分析

(2) 国内厂商竞争格局分析

4.9.4 通讯基带芯片前景预测

(1) 基带和应用处理器融合加深

(2) 价格战将加剧

(3) 工艺决定竞争力

4.10 家电控制芯片市场分析

4.10.1 家电控制芯片发展现状

4.10.2 家电控制芯片市场规模

4.10.3 家电控制芯片竞争格局

4.10.4 家电控制芯片前景预测

4.11 节能应用类芯片市场分析

4.11.1 节能应用类芯片发展现状

4.11.2 节能应用类芯片市场规模

4.11.3 节能应用类芯片竞争格局

4.11.4 节能应用类芯片前景预测

4.12 电脑数码类芯片市场分析

4.12.1 电脑数码类芯片发展现状

4.12.2 电脑数码类芯片市场规模

4.12.3 电脑数码类芯片竞争格局

4.12.4 电脑数码类芯片前景预测

第五章：中国芯片行业产业链分析

5.1 芯片设计行业发展分析

5.1.1 产业发展历程

5.1.2 市场发展现状

5.1.3 市场竞争格局

5.1.4 企业专利情况

5.1.5 国内外差距分析

5.2 晶圆代工产业发展分析

5.2.1 晶圆加工技术

5.2.2 国外发展模式

5.2.3 国内发展模式

5.2.4 企业竞争现状

5.2.5 市场布局分析

5.2.6 产业面临挑战

5.3 芯片封装行业发展分析

5.3.1 封装技术介绍

5.3.2 市场发展现状

5.3.3 国内竞争格局

5.3.4 技术发展趋势

(1) 技术发展的多层次化

(2) 由单一的提供芯片封测方案向封测的完整系统解决方案转变

(3) 同比例缩小技术演化突破

5.4 芯片测试行业发展分析

5.4.1 芯片测试原理

5.4.2 测试准备规划

5.4.3 主要测试分类

5.4.4 发展面临问题

5.5 芯片封测发展方向分析

5.5.1 承接产业链转移

5.5.2 集中度持续提升

5.5.3 国产化进程加快

5.5.4 产业短板补齐升级

5.5.5 加速淘汰落后产能

第六章：中国芯片产业下游应用市场分析

6.1 LED

6.1.1 全球市场规模

6.1.2 LED芯片厂商

6.1.3 主要企业布局

6.1.4 封装技术难点

6.1.5 LED产业趋势

6.2 物联网

6.2.1 产业链的地位

6.2.2 市场发展现状

6.2.3 物联网wifi芯片

6.2.4 国产化的困境

6.2.5 产业发展困境

6.3 无人机

6.3.1 全球市场规模

6.3.2 市场竞争格局

6.3.3 主流主控芯片

6.3.4 芯片重点应用领域

6.3.5 国产芯片发展方向

6.3.6 市场前景分析

6.4 北斗系统

6.4.1 北斗芯片概述

6.4.2 产业发展形势

6.4.3 芯片生产现状

6.4.4 芯片研发进展

6.4.5 资本助力发展

6.4.6 产业发展前景

6.5 智能穿戴

6.5.1 全球市场规模

6.5.2 行业发展规模

6.5.3 企业投资动向

6.5.4 芯片厂商对比

6.5.5 行业发展态势

6.5.6 商业模式探索

6.6 智能手机

6.6.1 市场发展形势

6.6.2 手机芯片现状

6.6.3 市场竞争格局

6.6.4 产品性能情况

6.6.5 发展趋势分析

6.7 汽车电子

6.7.1 市场发展特点

6.7.2 市场规模现状

6.7.3 出口市场状况

6.7.4 市场结构分析

6.7.5 整体竞争态势

6.7.6 汽车电子渗透率

6.7.7 未来发展前景

(1) 安全系统电子技术

(2) 主动安全电子技术

(3) 被动安全电子技术

(4) 车载电子系统技术

1) 智能导航系统

2) 车载信息系统

3) 自动汽车空调控制

(5) 汽车电子系统趋势：智能化、网络化、集成化

1) 智能化：信息输入输出

2) 网络化：总线信息共享

3) 集成化：跨系统一体化

6.8 生物医药

6.8.1 基因芯片介绍

6.8.2 主要技术流程

6.8.3 技术应用情况

6.8.4 生物研究的应用

6.8.5 发展问题及前景

第七章：中国芯片行业领先企业案例分析

7.1 芯片综合型企业案例分析

7.1.1 英特尔

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.2 三星

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.3 高通公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.4 英伟达

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.5 AMD

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.6 海力士

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.7 德州仪器

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.8 美光

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.9 联发科技

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.1.10 海思

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.2 芯片设计重点企业案例分析

7.2.1 博通有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.2.2 Marvell

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.2.3 赛灵思

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.2.4 Altera

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.2.5 Cirrus logic

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.2.6 展讯

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3 晶圆代工重点企业案例分析

7.3.1 格罗方德

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.2 Tower jazz

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.3 富士通

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.4 台积电

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.5 联电

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.6 力晶

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.7 中芯

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.3.8 华虹

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.4 芯片封测重点企业案例分析

7.4.1 Amkor

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.4.2 日月光

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.4.3 硅品

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.4.4 南茂

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.4.5 长电科技

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

7.4.6 天水华天

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.4.7 通富微电

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.4.8 士兰微

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第八章：中国芯片行业前景趋势预测与投资建议

8.1 芯片行业发展前景与趋势预测

8.1.1 行业发展前景预测

- (1) 芯片总体前景预测
- (2) 芯片细分领域前景预测

8.1.2 行业发展趋势预测

- (1) 行业市场发展趋势预测

1) 国产芯片已经取得突破，将会进一步发展

2) 行业整合加速

- (2) 行业产品发展趋势预测
- (3) 行业市场竞争趋势预测

8.2 芯片行业投资潜力分析

8.2.1 行业投资现状分析

8.2.2 行业进入壁垒分析

- (1) 技术壁垒
- (2) 人才壁垒
- (3) 资金实力壁垒
- (4) 产业化壁垒
- (5) 客户维护壁垒

8.2.3 行业经营模式分析

8.2.4 行业投资风险预警

- (1) 政策风险
- (2) 宏观经济风险
- (3) 供求风险
- (4) 其他风险

8.3 芯片行业投资策略与建议

8.3.1 行业投资价值分析

- (1) 行业发展空间较大
- (2) 行业政策扶持利好
- (3) 下游应用市场增长迅速
- (4) 行业目前投资规模偏小

8.3.2 行业投资机会分析

- (1) 宏观环境改善
- (2) 政策的利好
- (3) 产业转移
- (4) 市场因素

8.3.3 行业投资策略分析

- (1) 关于细分市场投资建议
- (2) 关于区域布局投资建议
- (3) 关于并购重组建议

图表目录

图表1：芯片产业链介绍

图表2：截至芯片行业标准汇总

图表3：截至芯片行业主要政策汇总

图表4：截至芯片行业发展规划

图表5：我国GDP及同比增速（单位：万亿元，%）

图表6：各月累计主营业务收入与利润总额同比增速（单位：%）

图表7：分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速（单位：%）

图表8：全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）

图表9：三次产业增加值占国内生产总值比重（单位：%）

图表10：我国宏观经济指标预测（单位：%）

图表11：年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数（单位：万户）

（GYZJY）

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行

年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/289387289387.html>